公司代码：688230　　公司简称：芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本117,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利70,560,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占2023年度归属于上市公司股东净利润的73.13%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述事项已获公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	芯导科技	688230	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	兰芳云	闵雨琦
办公地址	上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层	上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层
电话	021-60753051	021-60753051
电子信箱	investor@prisemi.com	investor@prisemi.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为功率半导体的研发与销售，公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类，公司产品可应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域。

（1）功率器件

公司功率器件产品主要包括瞬态电压抑制二极管（TVS）、金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、肖特基势垒二极管（SBD）、氮化镓（GaN HEMT）等。其中，公司的TVS产品主要为ESD保护器件。各产品介绍如下：

产品名称		产品图片	主要功能	应用领域	具体应用
瞬态电压抑制二极管（TVS）			具有瞬态高功率、超高吸收容量及低电压钳位能力，对电源线、信号线、输入端口等进行保护。	消费类电子、安防、网络通讯、汽车电子等领域	智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、汽车中控系统、智能保险丝、IPC、NVR、电子烟雾、CPE、MiFi、Dongle、GPON、EPON等设备的接口、触摸屏、USB、HDMI等接口的保护。
	ESD静电防护器件		吸收瞬间大电流，将两端电压箝制在一个极度的数值上，从而对后面的电路进行保护。	消费类电子、安防、网络通讯、汽车电子等领域	IPC、NVR、无人机、POS机、打印机设备、汽车中控系统、IPC、NVR、电子烟雾、CPE、MiFi、Dongle、GPON、EPON、光伏逆变、储能等设备的接口。
	浪涌防护（TVS）				
金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）			把输入电压从变化较大的电流的变化，限制在允许范围之内作用。	消费类电子、安防、网络通讯、汽车电子等领域	消费类电子、平板电脑、智能电子烟、TWS、POS机、无人机、网关、无线机器人、汽车中控系统、IPC、NVR、电子烟雾、CPE、MiFi、Dongle、GPON、EPON、光伏逆变、储能等设备的驱动和开关应用。
肖特基势垒二极管（SBD）			有效减小、开关电源、驱动电路中电压损失、电流、频率、相位等，实现精准调控。	消费类电子、安防、网络通讯、汽车电子、工业、储能等领域	智能手机、平板电脑、智能电子烟、TWS、POS机、无人机、网关、无线机器人、汽车中控系统、IPC、NVR、CPE、MiFi、Dongle、GPON、EPON、光伏逆变、储能、家电、电源等设备的整流桥开关应用。
绝缘栅双极型晶体管（IGBT）			IGBT通过加正向栅极电压形成沟道而导通，加反向栅极电压消除沟道使IGBT截止。IGBT主要作用是进行频率为50Hz的交流电和直流电的转换、电压变换的转换、能影响系统信号的不同步电路中的电压、电流、频率、相位等，实现精准调控。	能源变换、测试设备、智能家居、工业控制、新能源汽车、轨道交通、电力传输、航天航空、智能电网、光伏发电、风电、电动汽车充电桩、新能源汽车主驱系统、燃油车辅助系统等应用。	太阳能逆变器、风电变流器、智能家居、工业控制、轨道交通、电动汽车、新能源汽车主驱系统、燃油车辅助系统等应用。

（2）功率IC

公司的功率IC产品主要为电源管理IC，具体包括单节锂电池充电芯片、过压保护芯片、音频功率放大器、DC-DC类电源转换芯片、氮化镓驱动IC等。各产品介绍如下表所示：

产品名称	产品图片	主要功能	应用领域	具体应用
氮化镓驱动IC		用于电力电子领域的能量转换开关及控制。	消费类电子、网络通讯、汽车等领域	智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、汽车中控系统、智能保险丝、IPC、NVR、电子烟雾、CPE、MiFi、Dongle、GPON、EPON等设备的接口、触摸屏、USB、HDMI等接口的保护。
单节锂电池充电芯片		用于锂电池充电，并具有多种保护功能，如电池短路、信号断、输入端已经可靠进行保护。	消费类电子、安防等领域	手机、平板、智能手表等便携式电子设备；车载行驶仪、电动扫地机、IoT、移动电源、电子烟、智能单锂电池供电设备的充电管理。
过压保护芯片		应用于电子产品的电源输入口处，实现过压保护、过热保护、过流保护等功能。	消费类电子、安防等领域	手机、平板、智能手表等便携式电子设备；车载行驶仪、电动扫地机、IoT、移动电源、电子烟、智能单锂电池供电设备的充电管理。
音频功率放大器		用于放大微弱的音频信号，以驱动扬声器发出音量合适的声音，内部集成了多种功能。	消费类电子、网络通讯、安防等领域	蓝牙音箱、智能音箱、共享单车、扫码器、玩具等设备音频驱动。
DC-DC类电源转换芯片		电压转换器将一定范围直流电压升高或降低至合适值，为设备供电。	消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域	计算机CPU、存储器等模块的供电，手机、平板、智能音箱等设备的供电。

（二）主要经营模式

公司自设立以来一直采用Fabless的经营模式进行产品研发和销售。在Fabless模式下，公司专注于功率半导体相关产品的设计，将晶圆制造和封装测试环节均采用外协加工的方式委托专业的生产厂商进行加工，由外协厂商负责生产。

（1）产品研发模式

公司采用Fabless经营模式，产品研发环节是整个经营活动的核心环节。公司始终密切关注行业前沿技术，紧跟客户需求和市场变化趋势，打造自主研发的技术平台，并以此为基础，持续推进技术迭代，丰富产品种类和型号，拓展应用领域，从而实现产品的技术先进性以及较强的市场竞争力。

（2）采购与生产模式

公司采用集成电路行业典型的Fabless经营模式，专注于功率半导体产品的研发和销售环节，晶圆制造和封装测试等环节主要通过委托外协的方式完成。

（3）销售模式

根据行业、产品及市场情况，公司主要采取“经销为主，直销为辅”的销售模式。

（二）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于集成电路设计行业，根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事的相关业务属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2023年，受地缘政治形势、全球经济环境、行业周期等因素影响，全球半导体行业依然深处谷底，以智能手机为代表的消费电子领域整体表现持续低迷，直到2023年下半年市场才逐步回暖。据半导体产业协会(SIA)数据显示，2023年全球半导体产业销售额为5,268亿美元，比2022年的5,741亿美元下降了8.2%；2023年第四季度全球半导体产业的销售额为1,460亿美元，同比增长11.6%，环比增长8.4%。

Canalys发布的报告指出，2023年全球智能手机出货量为11.4亿台，跌幅较2022年收窄至4%；2023年第四季度，全球智能手机市场同比增长8%至3.195亿台。IDC数据显示，2023年中国智能手机出货量约为2.71亿台，同比下降5%；2023年第四季度，中国智能手机出货量约为7,363万台，同比增长1.2%。

2022年以来，美国及其盟国从半导体生产设备、设计软件到相关原料等对中国实施了一系列管制措施，以进一步限制中国先进的芯片制造和人工智能技术的发展。受复杂的外部环境因素影响，集成电路产业实现自主可控的要求越来越迫切，国产替代进口需求空间巨大，具有自主核心技术的国产芯片份额会有极大的提升。

公司产品主要包括功率器件和功率IC，功率器件产品主要为TVS（包括ESD保护器件）、MOSFET、肖特基等；功率IC产品主要为电源管理IC。公司产品具有高性能、低损耗、低漏电、小型化的特点，可应用于消费电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域。公司在继续深耕消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域的同时，也在积极将产品向汽车电子、光伏储能等领域拓展。根据Yole报告，新能源变革为功率半导体行业带来巨大增长空间，全球功率半导体市场将从2021年的461亿美元增长到2027年的596亿美元，复合年均增长率为4.4%。

功率半导体行业属于典型的知识密集型行业，需要融合多种专业技术，跨越多个学科领域，如半导体器件物理、电路设计、产品工艺、应用方案设计等，且技术更新速度快，需要从业人员持续不断地学习、积累，行业技术门槛较高。

公司的功率半导体产品，具有需要多种专业融合、对设计能力和持续创新能力要求高、需要对晶圆制造工艺及封装工艺具有深刻的理解和掌握等特点；产品结构设计技术和产品工艺设计技术难度大、产品测试要求高；同时，品牌客户对企业的认证周期长、对产品的测试验证要求高、一般的功率器件设计企业开拓品牌客户的难度较大，因此具有较高技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业、上海市规划布局内重点集成电路设计企业、上海市科技小巨人企业、上海市高新技术企业、上海市三星级诚信创建企业、上海市“专精特新”企业、上海市集成电路行业协会第五届理事会理事单位。

公司自主研发的一种降低芯片反向漏电流的技术、深槽隔离及穿通型NPN结构技术、MOSFET的沟槽优化技术、沟槽MOS型肖特基势垒二极管的改进技术、可连续调节的占空比环路控制技术、一种复合DC-DC电路、一种负载识别电路等核心技术显著提升了公司产品的技术水平及市场竞争力，具有国内领先水平。一种GaN HEMT器件制备技术，优化了终端结构，降低工艺开发过程引入的漏电风险，同时优化了终端结构，使得GaN HEMT产品具有芯片良率高、可靠性良好的特性。公司已经正式发布具有自主专利技术的GaN HEMT产品，并在多个客户端进行验证，是第二代半导体产品较早开发成功的国内企业。

公司的功率器件及功率IC产品，具有高性能、低功耗、小尺寸的特点，产品市场目前主要被德州仪器（TI）、安森美（ON Semiconductor）、商升特半导体（Semtech Corporation）等国外半导体厂商占据，国产化替代空间巨大。随着公司产品不断向汽车电子、光伏储能等领域拓展，公司产品的应用需求将进一步释放，市场前景广阔。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）半导体市场发展趋势

2022年以来，在贸易摩擦、全球通胀等多重因素导致需求收缩的背景下，半导体市场进入下行周期，2023年芯片市场依旧需求疲软，供应链库存消耗过程仍在继续。不过，对于半导体行业而言，最坏的时刻正在过去。半导体产业协会(SIA)表示，2024年半导体销售额有望摆脱萎缩转为增加，预计将增长13.1%。世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测2024年全球半导体市场将同比增长13.1%达5,880亿美元。随着智能手机需求的逐步复苏以及对AI芯片的强劲需求，IDC预计，半导体市场将在2024年回归增长趋势，年增长率将在20%以上。

由于中美科技摩擦不断，美对华技术封锁措施持续出台，加之全球多区域加强本土半导体产业的扶持，半导体产业呈现明显的逆全球化趋势。我国从中央到地区纷纷出台了多项支持半导体产业发展的政策，各地政府也加强建设集成电路等产业集群，旨在提升本土半导体制造业的规模，突破关键核心技术，解决“卡脖子”问题，加速推进我国半导体的国产化进程。

为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国近年来推出了一系列支持半导体产业发展的政策，主要如下：

发布时间	法规、政策名称	发布单位	内容摘要
2022年	《关于深化电子器行业管理制度改革的意见》	国务院	提出了五方面改革举措，包括优化电子电器产品准入管理制度、整合绿色产品评定认证制度、完善支持基础电子产业高质量发展的制度体系、优化电子电器行业流通管理制度、加强事前事中事后全链条全领域监管。
2022年	《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》	发改委	脑准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。
2021年	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	工业和信息化部	提出“实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定。”“重点产品高端提升行动”中明确在电路类元器件中重点发展耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块、小型化、高可靠、高灵敏度电子防护器件，高性能、多功能、高密度混合集成电路。
2021年	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	工业和信息化部、科技部、财政部等六部门	提出要“提高优质企业自主创新能力，……加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。”
2020年	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国务院	国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
2020年	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》发改高技〔2020〕1409号	国家发改委	在“聚焦重点产业投资领域”中提出“加快新一代信息技术产业提质增效。加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。”
2020年	《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》（商服贸发[2020]12号）	商务部等8部门	将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划（专项、基金等）支持范围。

复杂的外部环境因素迫使集成电路产业实现自主可控要求越来越迫切，国产替代进口需求空间巨大，具有自主核心技术的国产芯片份额会有极大的提升。国内终端厂商逐步将供应链转移至国内，有助于真正发挥上下游联动发展的协同作用，半导体产业的国产替代持续加速进行，给中国本土企业带来了绝佳的市场机会。

当前半导体产业正在发生深刻的变革，其中新材料成为产业新的发展重心。以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等材料为代表的新材料半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而受到行业关注，将成为新型的半导体材料。SiC、GaN等半导体材料属于新兴领域，相关产品的技术开发具有应用战略性和前瞻性。GaN功率器件开关频率高、导通电阻小、电容小、禁带宽度大、耐高温、能量密度高、功率密度大，可在高频情况下保持高效率水平工作，将有望被广泛运用于5G通讯、智能电网、快充电源、无线充电等领域。市场空间巨大。越来越多的企业加入了第三代半导体器件的开发行列。

展望未来，国产替代和创新浪潮仍是未来电子行业的发展主轴。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要加快发展现代产业体系，坚持自主可控、安全高效，加快补齐基础元器件的瓶颈短板，半导体产业未来发展可期。

（2）智能消费类电子领域

智能手机出货量在经历了近2年的低谷后，随着重磅手机的陆续发布，市场热度持续升温，出现复苏态势。市场调查机构Counterpoint数据显示，2023年第四季度，智能手机出货量同比增长3%，达到3.12亿部，预计2024年全球智能手机出货量有望同比增长3%。同时，加拿大市场调研机构TechInsights发布报告称，2024年全球消费电子行业收入将突破1万亿美元，同比增速约为5.4%。TechInsights表示，这反映出用户对技术的依赖，以及在多个产品类别中对高端设备日益增长的偏好。未来，需求将受到智能家居和可穿戴市场的先进技术产品推动。同时，随着人工智能等创新尖端技术的整合，消费电子行业将引领一场技术变革，推动新的增长潜力。

然而，德国数据统计公司Statista对2024年消费电子行业发展，持并不乐观的发展态势预测，2024年全球消费电子产品支出将减少53亿美元至10,463亿美元，降幅为0.5%。可见，研究机构对于全球消费电子市场的展望存在着不同看法，这也意味着行业发展仍存在不确定性。

报告期内，公司积极推动产品升级迭代，基于自有的成熟设计模块，推陈出新，开发出了效率更高、更智能化的全系列充电芯片、保护芯片等产品。公司针对移动终端小型化的场景推出了超小封装产品系列，以其高性能、低损耗、低漏电的特点，不但助力客户产品实现更紧凑的功能布局，打造轻巧精致的设备外观，更为其安全使用保驾护航。

（3）功率半导体

受益于双碳时代背景，以新能源汽车、新能源发电为代表的产业将迎来长期发展机会，功率器件作为核心零部件也将随着迎来发展机遇。功率器件持续迭代升级，向高压、高功率、低功耗方向发展。功率器件从二极管、晶闸管发展到MOSFET、IGBT，再到第三代半导体器件，经历了长期的技术积累和产品迭代，技术门槛不断提高。随着电动汽车、新能源发电、工业控制等下游应用的快速发展，对高压、高电流、高频率、高功率的需求推动功率器件厂商不断优化升级，在更新换代的过程国产厂商有望实现新突破。全球功率半导体尤其是高端的功率器件主要被英飞凌、安森美、三菱、富士等欧美日大厂占据，国产厂商未来提升空间巨大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,281,544,663.25	2,212,822,221.31	2,212,763,331.58	3.11	2,148,300,036.16	2,148,226,007.94
归属于上市公司股东的净资产	2,222,549,376.04	2,171,101,243.54	2,171,100,979.68	2.37	2,087,647,351.44	2,087,654,665.42
营业收入	320,426,744.62	336,147,850.09	336,147,850.09	−4.68	475,649,458.03	475,649,458.03
归属于上市公司股东的净利润	96,487,677.18	119,453,892.10	119,446,314.26	−19.23	114,518,972.62	114,526,286.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,575,481.25	65,419,090.50	65,411,512.66	−33.39	108,481,032.25	108,488,346.23
经营活动产生的现金流量净额	69,079,725.90	64,210,970.12	64,210,970.12	7.58	91,553,496.99	91,553,496.99
加权平均净资产收益率(%)	4.39	5.61	5.61	减少1.22个百分点	32.49	32.49
基本每股收益（元/股）	0.82	1.02	1.02	−19.61	1.26	1.26
稀释每股收益（元/股）	0.82	1.02	1.02	−19.61	1.26	1.26
研发投入占营业收入的比例(%)	13.47	10.35	10.35	增加3.12个百分点	6.19	6.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	54,098,967.00	77,061,188.43	92,484,979.89	96,781,609.30
归属于上市公司股东的净利润	15,922,616.68	22,346,763.04	25,950,018.30	32,268,279.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,277,888.38	8,752,606.88	13,885,722.47	18,659,263.52
经营活动产生的现金流量净额	11,057,080.43	18,533,482.78	19,063,001.37	20,426,161.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,875
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,409
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海芯导企业管理有限公司	12,852,000	44,982,000	38.25	44,982,000	44,982,000	无		境内非国有法人
欧新华	10,080,000	35,280,000	30.00	35,280,000	35,280,000	无		境内自然人
上海萃慧企业管理服务中心（有限合伙）	2,268,000	7,938,000	6.75	7,938,000	7,938,000	无		其他
国元证券-招商银行-国元证券芯导科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	107,206	901,500	0.77			无		其他
国元创新投资有限公司	335,800	882,000	0.75			无		国有法人
香港中央结算有限公司		533,016	0.45			无		其他
王永杰		341,412	0.29			无		境内自然人
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金		279,918	0.24			无		其他
魏君	142,520	272,520	0.23			无		境内自然人
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金		262,571	0.22			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	欧新华系公司控股股东苓导企管的唯一股东和执行董事，系萃慧企管的执行事务合伙人并持有萃慧企管27.75%的财产份额，苓导企管、萃慧企管系实际控制人欧新华的一致行动人。国元创新投资有限公司为国元证券的全资子公司，国元证券芯导科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的管理人和实际支配主体为国元证券。此外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

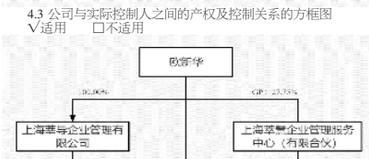
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，按露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现销售收入32,042.67万元，较上年同期减少4.68%；实现归属于上市公司股东的净利润9,648.77万元，较上年同期减少19.23%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,357.55万元，较上年同期减少33.39%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688230　　证券简称：芯导科技　　公告编号：2024-012

上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月17日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司2024年董事薪酬的议案》	√
7	《关于公司2024年监事薪酬的议案》	√
8	《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

注：本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、3-6、8、9已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案2-5、7-9已经公司第二届监事会第十次会议审议通过。相关公告已于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688230	芯导科技	2024/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章），本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2023年5月13日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）

（三）登记地点

上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层，公司证券部。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系部门：公司证券部

电话：021-60753051

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海芯导电子科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》			
6	《关于公司2024年董事薪酬的议案》			
7	《关于公司2024年监事薪酬的议案》			
8	《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》			
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688230　证券简称：芯导科技　公告编号：2024-011

上海芯导电子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“芯导科技”）于2024年4月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币41,500万元用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币202,215.00万元，扣除发行费用人民币19,166.13万元后，募集资金净额为人民币183,048.87万元，其中超募资金金额138,672.87万元。前述募集资金已于2021年11月26日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]44197号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金(万元)
1	高性能分立功率器件开发和升级	13,861.00	13,861.00